

各 位

会 社 名 株式会社 アパールデータ
 代 表 者 名 代表取締役社長 嶋 村 清
 (JASDAQ コード番号 6918)
 問 い 合 わ せ 先 管理本部 部長 大関 拓夫
 T E L 042-732-1000

平成21年3月期業績予想（連結・個別）及び配当予想の修正に関するお知らせ

平成20年5月15日付「平成20年3月期決算短信」において発表いたしました平成21年3月期（平成20年4月1日～平成21年3月31日）の業績及び配当予想を下記のとおり修正いたします。

記

I.平成21年3月期第2四半期累計期間・通期業績予想（連結・個別）の修正について

1.平成21年3月期第2四半期累計期間・通期業績予想（連結・個別）の修正

〔 連結業績予想 〕

平成21年3月期第2四半期連結累計期間業績予想の修正（平成20年4月1日～平成20年9月30日）

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1株当たり当期 純利益 (円銭)
前回発表予想 (A) (平成20年5月15日発表)	3,370	255	305	200	25.59
今回修正予想 (B)	3,110	76	130	94	12.03
増減額 (B-A)	△260	△179	△175	△106	—
増 減 率	△7.7%	△70.2%	△57.4%	△53.0%	—
前 期 実 績 (平成19年9月中間期)	4,554	603	631	361	46.29

平成21年3月期通期連結業績予想の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1株当たり当期 純利益 (円銭)
前回発表予想 (A) (平成20年5月15日発表)	7,700	830	920	550	70.37
今回修正予想 (B)	6,500	316	406	255	32.62
増減額 (B-A)	△1,200	△514	△514	△295	—
増 減 率	△15.6%	△61.9%	△55.9%	△53.6%	—
前 期 実 績 (平成20年3月期)	8,465	929	989	582	74.59

[個別業績予想]

平成21年3月期第2四半期累計期間業績予想の修正（平成20年4月1日～平成20年9月30日）

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1株当たり当期 純利益 (円銭)
前回発表予想 (A) (平成20年5月15日発表)	2,250	205	295	210	26.87
今回修正予想 (B)	2,050	80	172	136	17.40
増減額 (B-A)	△200	△125	△123	△74	—
増減率	△8.9%	△61.0%	△41.7%	△35.2	—
前期実績 (平成19年9月中間期)	3,109	434	523	348	44.62

平成21年3月期通期業績予想の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1株当たり当期 純利益 (円銭)
前回発表予想 (A) (平成20年5月15日発表)	5,000	570	700	470	60.13
今回修正予想 (B)	4,280	240	367	261	33.39
増減額 (B-A)	△720	△330	△333	△209	—
増減率	△14.4%	△57.9%	△47.6%	△44.5%	—
前期実績 (平成20年3月期)	5,548	643	763	517	66.26

2. 業績予想の修正理由

[連結業績予想]

当社グループに関連の深い半導体製造装置業界は、昨年末より急激な減速傾向を示しており、今年度の業績等の予想にあたり大幅な減少を予測しておりました。しかしながら半導体メーカーの設備投資の抑制が長期化するなど半導体製造装置市場は予想以上の低迷が継続しております。このような状況に対して、当社グループは自社LSIを搭載した競争力の高い製品の投入や新規顧客の積極的な開拓を進めてまいりましたが、当社グループの主要品目であります受託製品・半導体製造装置及びその関連分野の自社製品・組込みモジュールが大きな影響を受け、第2四半期累計期間において計画を大幅に下回るものと予測いたしております。一方、受託製品・産業用制御装置におきましては、市況は減速傾向であるものの、新製品の投入や新規顧客の開拓が順調にすすみ、概ね計画どおりに推移する見込みであります。

営業利益におきましては、受託製品・半導体製造装置の需要の減少及びそれに伴う生産稼働率の低下並びに利益率の高い自社製品の売上減少により、計画を大幅に下回る見込みであり、また加えてこれに伴い経常利益及び当期純利益におきましても上記のとおり修正いたします。

また通期業績予想につきましては、一部のメーカーによる設備投資の再開により今後、半導体製造装置の受注は緩やかな増加が見込めるものの本格的な回復は来期になるものと見込んでおり下

期も上期とほぼ同様の環境が続くものと予想しておりますので上記のとおり修正いたします。

このような状況において平成20年5月15日に発表いたしました第2四半期累計期間及び通期の連結業績予想を上記のとおり修正いたします。

[個別業績予想]

連結業績予想の修正理由と同様の理由により、個別業績予想におきましても平成20年5月15日に発表いたしました第2四半期累計期間及び通期の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益を上記のとおり修正いたします。

II.平成21年3月期中間および通期配当予想

1. 配当予想の修正理由

当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要施策の一つと考え、各期の連結業績に応じた利益の配分を基本方針としております。そして将来の企業価値向上に向けた事業投資に伴う中長期的な資金需要や財務状況の見通しなどを総合的に勘案し、連結配当性向を30%に高めるべく配当性向の向上を目指して株主の皆様への成果配分を行ってまいりました。

しかしながら、既述のとおり、平成21年3月期第2四半期連結累計期間の連結当期純利益が、94百万円に、また、平成21年3月期通期の連結当期純利益が255百万円となる見込みであります。

このような状況においても株主の皆様の長期的な視点を配慮しつつ安定的な配当を行うこととし、誠に遺憾ながら平成21年3月期中間期末におきましては1株当たりの配当金を7円（前回予想、11円）、期末におきましては当社50周年記念の記念配当5円を加え13円（前回予想、記念配当5円を加え16円）、従いまして年間配当金を20円とさせていただく見込みです。

2. 配当予想の修正内容

基準日	一株当たりの配当金		
	中間期末	期末	年間
前回予想 (平成20年5月15日発表)	11円	16円(注)	27円
今回修正予想	7円	13円(注)	20円
前期(平成20年3月期) 実績	15円	8円	23円

(注) 前回予想及び今回修正予想の期末配当には、記念配当5円を含めております。

以上

ご注意 : 上記の業績予想及び配当予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

第50期 業績予想修正・連結(品目別)

品目別(連結)2008年4月1日－2009年3月31日

単位 百万円

品目	項目	連結業績							
		第2四半期累計期間				通期			
		08/5/15 発表値	08/9/19 発表値	増減率	前年同期 実績	08/5/15 発表値	08/9/19 発表値	増減率	前年同期 実績
自社製品	組込みモジュール	413	310	-24.9%	581	930	670	-28.0%	995
	画像処理モジュール	310	301	-2.9%	273	650	631	-2.9%	559
	計測通信機器	430	316	-26.5%	535	960	756	-21.3%	1,144
受託製品	半導体製造装置	1,200	1,075	-10.4%	2,166	2,770	2,245	-19.0%	3,654
	産業用制御装置	505	565	11.9%	459	1,160	1,080	-6.9%	892
	計測機器	415	395	-4.8%	488	990	840	-15.2%	976
商品(自社製品関連)		97	148	52.6%	53	240	278	15.8%	245
売上合計		3,370	3,110	-7.7%	4,554	7,700	6,500	-15.6%	8,465
営業利益		255	76	-70.2%	603	830	316	-61.9%	929
経常利益		305	130	-57.4%	631	920	406	-55.9%	989
当期純利益		200	94	-53.0%	361	550	255	-53.6%	582